

D1F60

600V 1A

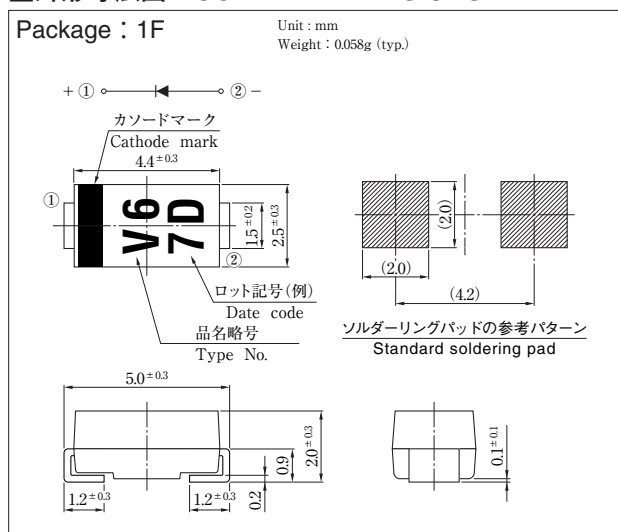
特長

- 耐湿性に優れ高信頼性
- 自動実装対応

Feature

- High-Reliability
- for Auto-Mount

■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



(製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください)

■定格表 RATINGS

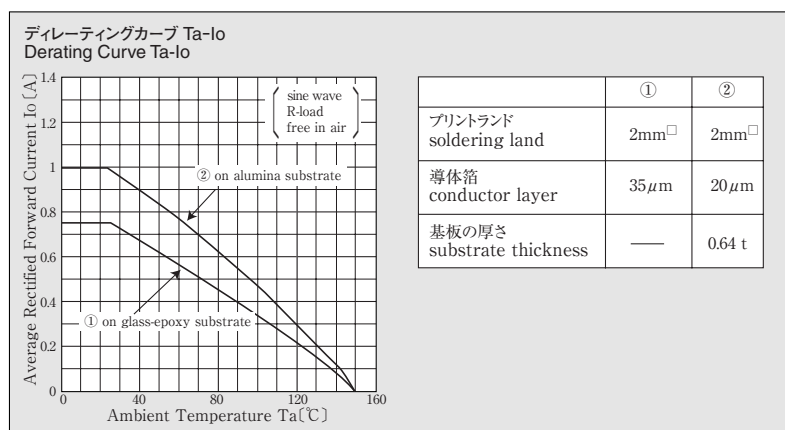
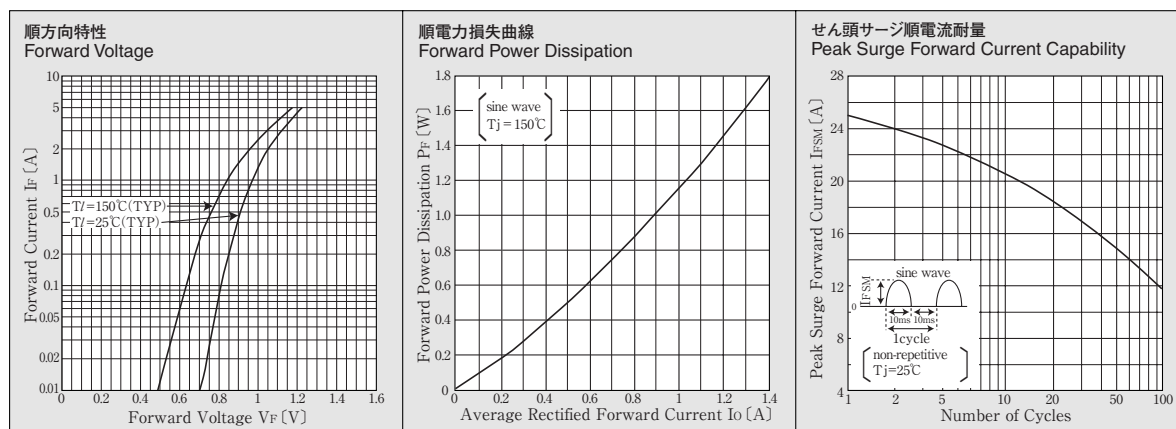
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D1F60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			-55~150	$^\circ\text{C}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150	$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, $T_a = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, $T_a = 25^\circ\text{C}$	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1	A
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	0.75	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$		25	A

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 1\text{A}$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 1.1	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jl}	接合部・リード間 Junction to Lead	MAX 23	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	θ_{ja}	接合部・周囲間 Junction to Ambient	アルミナ基板実装 On alumina substrate	MAX 108
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	MAX 157

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- ・ Sine waveは50Hzで測定しています。
- ・ 50Hz sine wave is used for measurements.
- ・ 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。Typicalは統計的な実力を表しています。
- ・ Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.